

证券代码：601231  
转债代码：113045

证券简称：环旭电子  
转债简称：环旭转债

## 环旭电子股份有限公司 2023 年第三季度业绩说明会活动记录

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
时间	2023 年 11 月 28 日
地点	东方财富路演平台 <a href="https://roadshow.eastmoney.com/luyan/4370020">https://roadshow.eastmoney.com/luyan/4370020</a>
上市公司 参会人员	史金鹏（董事会秘书）、刘丹阳（财务总监）
业绩说明会 Q&A 记录	<p><b>【问题】</b>近期市场相继推出了 AI+的消费电子产品，如 AI PC、AI 手机、AI Pin 等，请问公司如何看待 AI+消费电子未来的发展前景？公司是否有机会参与到 AI+消费电子的业务中来？</p> <p><b>【回答】</b>AI 是今年特别热的话题，从年初的 AIGC、ChatGPT，到算力芯片、AI 服务器，一直备受市场和投资人关注。</p> <p>当下 AI 相关的消费电子产品陆续发布，如提到的 AI Pin、AI Phone 等，我觉得这会是消费电子后续非常重要的创新方向，简单说以下两个发展趋势值得大家关注：</p> <p>1. 消费电子产品将更加智能化，大大提升消费体验</p> <p>大家已经看到 AI 技术的快速迭代，目前已经可以很好地理解客户需求，并给总体而言比较令人满意，甚至是大大超出预期的结果。如果说过去的 20 年是互联网、物联网时代，未来的 20 年就是智能化时代。智能化将带动消费电子产品的全面升级。</p> <p>比如，AI 在图像识别、语音识别已有广泛应用，AI 未来将在交互方式、大数据智能、实时反馈等诸多方面改变人类的生活，虽然做不到无所不能，但一定是无所不在。</p>

## 2. AI 时代需要算力升级和无线通讯技术的升级

AI 需要大算力、大模型很容易理解。AI 也需要无线通讯技术的升级，需要更大的带宽，实现大数据的传输，需要更低的延时，尽量缩短响应和反馈时间，保证体验的及时性，还需要更好的安全性，保护数据安全传输和用户隐私。因此，Wifi7、毫米波、UWB 等无线通讯技术将加快应用。

结合环旭电子现有的产品和业务，SiP 模组、AI 和边缘服务器、高速交换机等产品将在 AI+ 的时代率先获得收益。

以 SiP 模组为例，SiP 具有轻薄短小、高集成度、低功耗、高可靠性的特点，环旭电子生产的 SiP 模组已广泛用于全球最知名消费电子品牌的智能手机、智能穿戴、智能家居等全系列产品上。刚才讲到 AI 将推动消费电子产品的智能化，下一代的消费电子产品一定具备更强的边缘算力、更大的数据吞吐能力、更强的环境感知能力、更高的集成度，SiP 模组“两高一低”的特性，最能适应这样的趋势，将有广阔的应用空间。

**【问题】** 公司是全球 SiP 模组领域的龙头厂商，请介绍一下公司未来 SiP 在哪些领域有业务机会？

**【回答】** 公司的 SiP 模组当前主要应用于智能手机、智能手表、TWS 耳机、平板/笔记本电脑、其他物联网设备中，涉及的模组类型包括 WiFi/BT Module、5G mmWave AiP、UWB Module、All-in-One Module 等。未来随着消费电子产品模组化需求的增加，包括像 WiFi 6E/7 Module、MR/VR/AR Module、RF Module、CPU Module 等类型的 SiP 模组都将有望大规模应用，这也是公司重点布局的方向。

除了公司的大客户以外，公司也将持续拓展全球各知名消费电子品牌、汽车品牌的业务机会，将 SiP 模组的业务机会延展至更多客户的智能手机、智能穿戴、电脑、汽车等领域中，进一步强化公司模组化的全球领导者地位。

**【问题】** 请问公司如何看待后续在算力相关的服务器、交换机等业务的发展机会？

**【回答】** 今年随着 ChatGPT、AIGC 引爆 AI 在各行各业的应用点，人工智能成为了最热门的话题，对于算力的需求也开始井喷式的成长。公司目前在云端及存储板块中，交换机的业务受下游景气度的刺激，今年成长较快，收入有望达到近 1 亿美金，明年亦有望持续较快成长。在服务器主板方面的业务，公司目前与 AI 服务器相关的业务还较少，更多的是云计算、数据

中心相关的服务器主板，今年受全球通胀、需求下降的影响，有较大降幅，未来公司将着力发展边缘服务器等具备特色的产品，寻找业务突破机会。虽然现在 AI 服务器以及边缘服务器，在公司的占比较低，但由于算力需求爆发，把高速交换机业务迅速拉高，环旭电子已经有一些布局，预估未来 3 年，云端与存储这部分业务将有 50% 的成长潜力。

**【问题】**今年人民币对美元整体贬值，进去人民币开始升值，请说明一下公司今年整体受汇率影响的情况？

**【回答】**

本公司以人民币报表公告损益，而公司主要涉及交易的货币除人民币外主为美金其次为台币、欧元、墨币及越南盾等。公司主要交易以美金计价，再换算为人民币报表金额，海外子公司在合并时也会先依当地货币换算为美金再再换算为人民币报表金额。

费率变化会造成公司影响损益变化主要为两方面：

1、在经营层面公司以外币计价的收入及成本费用造成公司影响损益变化

今年以来美元先贬后升，以平均汇率试算汇率对 2023 H1 同比损益的造成的影响基本持平，第三季大约有 0.3% 有利影响，公司与主要客户的条款中会考虑汇率变化对价格的调整以降低汇率对营业方面的影响。

2、公司须对期末的外币资产及外币负债就期末外币兑人民币汇率进行评价

相关汇率造成的影响及相关避险成本会体现在公司的财务费用、投资收益、公允价值变动收益等科目。今年以来美元先贬后升，特别是一月美金又有较大贬值，造成在今年初有产生汇兑损失，在第一季报告已经说明。第三季平均汇率回到 7.2 以上，由于第三季进入采购旺季美金需求增加使风险扩大，透过避险操作截至第三季兑换损失大幅缩小到 RMB 3.1M。公司外汇避险政策主要是对此方面进行避险操做，针对实际及预计的外币资产及负债风险部位主要进行净部位的避险，务求将风险降至最低。

**【问题】**请说明一下今年的资本开支情况？明年预计的支出水平如何？

**【回答】**2023 年目前的资本支出规划，与第二季说明会时预估的总金额相比有所增加，合计约 USD275M。主要因持续投资墨西哥等境外生产厂房，使建筑相关支出将较 2022 年有所增加。生产设备部份，仍将投资重点放在 SiP 的设备、工业及汽车电子相关产品投资上，2023 生产设备 USD164M，其中约 30% 为 SiP 相关投资，剩余则为其他其他产品线投资，建筑相关

USD104M, IT 设备及其他设备投资 USD7M。

**【问题】**全世界产业链有所变化, 请问公司在全球的产业布局如何?

**【回答】**从 2018 年中美贸易摩擦升级以来, 五年的时间, 包含 3 年疫情, 全球供应链发生了很大的变化。之前是“中国制造, 服务全球”, 当先开始讲 China+1 的模式, 讲全球化在地化趋势, 先是越南、后是墨西哥, 都成为中国企业海外布局的热点地区。

环旭电子从 2018 年开始提出全球化战略, 策略实施卓有成效, 目前在欧美亚非 10 个国家和地区拥有 28 个生产据点, 服务于全球各细分领域的龙头企业。去年下半年墨西哥厂购买土地, 新建第二工厂, 今年波兰厂第二栋厂房也开始建设, 预计在 2024 年中都可以完工投产。海外投资的新产能, 主要服务汽车电子、工业类产品的新增订单。未来 3 年, 公司整体产能将增加约 50%, 除了增加产能, 公司也会通过生产流程优化以及自动化, 提高产业竞争力。

**【问题】**公司刚刚有提到 AI Pin, 请问公司有为 AI Pin 提供 SiP 模组吗?

**【回答】**公司目前未涉及 AI PIN 相关业务。AI+消费电子产品其对轻薄短小、高集成度、低功耗、高可靠性的要求会越来越高, 这与 SiP 模组的特点正好契合, 相信未来 SiP 模组有机会在更多品牌的不同的消费电子产品中得到应用。

**【问题】**公司服务器主板、交换机等相关业务占总营收的比重是多少? 有 AI 的业务机会吗?

**【回答】**公司“云端及存储类”业务在 2022 年约占公司营收总额的 10%, 在 2023 年前三季度约占公司营收总额的 8.1%, 其中主要产品包括标准机架服务器/边缘服务器的主机板、高速交换机、数据网卡、SSD 产品、拓展坞等, 均可用于 AI、边缘计算、云计算、数据中心等领域的核心设备。

**【问题】**新能源汽车具体提供哪些项目可以说一下嘛

**【回答】**公司在汽车电子业务中的“电动化”领域, 主要为根据客户需求, 以 EMS+或 JDM 方式提供代工制造服务, 为客户提供从功率模组、到控制板、再到具体动力总成产品的垂直一体化制造服务, 涉及到的具体产品包括 IGBT/SiC 功率模组、驱动逆变器、BMS、OBC 等产品, 服务的客户类型包括 IDM/Fabless 厂商、整车厂、Tier1 厂商。

	<p><b>【问题】</b>公司对交换机业务怎么看？</p> <p><b>【回答】</b>公司主要为 Mellanox 提供交换机整机代工业务，当前行业景气度较好，虽然公司今年交换机业务较去年有不错的成长，但整体规模仍然较小，预计今年交换机占公司营收规模约 1%左右。明年行业景气度依然旺盛，公司的交换机业务亦有很好的成长机会。</p> <p><b>【问题】</b>公司的 SiP 份额未来有机会继续提高吗？</p> <p><b>【回答】</b>通讯类产品及消费电子类为公司业务占比最高的产品类别，其中的大部分业务主要为 SiP 模组化相关产品，包括用于客户智能手机、智能手表、TWS 耳机、电脑/平板、智能家居等产品中。公司是 SiP 模组领域的龙头厂商，在公司主要客户的 SiP 模组领域占据领先的竞争地位，未来公司仍将继续努力保持公司的市场地位。</p> <p><b>【问题】</b>什么时候有 sip 这个概念股</p> <p><b>【回答】</b>公司 2012 年在上交所上市，上市前已为客户提供 WiFi 模组产品，后续随着业务的发展也相继为客户推出了智能手表模组、TWS 模组、UWB 模组、AiP 模组等产品，当前已成为全球出货量最大的 SiP 模组厂商。</p> <p><b>【问题】</b>公司有光伏、储能方面的业务吗？</p> <p><b>【回答】</b>公司目前有为北美客户供货储能相关产品，具有较好的成长前景。</p>
<b>附件清单（如有）</b>	无
<b>日期</b>	2023 年 11 月 28 日